



各 位

2020年8月6日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 和 正
 (コード番号 6855 東証第一部)
 問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝
 電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

業績予想及び配当予想に関するお知らせ

2020年5月25日に公表いたしました「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」において、未定としておりました2021年3月期の業績予想及び配当予想につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 連結業績予想について

(1) 2021年3月期第2四半期(累計)連結業績の予想(2020年4月1日~2020年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する四半 期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	百万円 —	百万円 —	百万円 —	百万円 —	円 銭 —
今回発表予想(B)	7,700	1,200	1,200	900	84.99
増減額(B-A)	—	—	—	—	
増減率(%)	—	—	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (2020年3月期第2四半期)	6,819	461	415	375	35.44

(2) 2021年3月期通期連結業績の予想(2020年4月1日~2021年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期 純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A)	百万円 —	百万円 —	百万円 —	百万円 —	円 銭 —
今回発表予想(B)	17,000	2,300	2,200	1,700	160.54
増減額(B-A)	—	—	—	—	
増減率(%)	—	—	—	—	
(ご参考)前期実績 (2020年3月期)	15,669	1,012	993	1,076	101.62

(3) 連結業績予想の概要

当連結会計年度の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症による影響を合理的に算定することが困難な状況であったことから未定としておりましたが、現時点において入手可能な情報に基づき、当社グループの2021年3月期の連結業績を上記のとおり予想しております。

当連結会計年度の世界経済は、同感染症の影響により予断を許さない状況にありますが、当社グループの主たる事業分野である半導体市場は、次世代通信規格(5G)や人工知能(AI)、IoTの普及等に牽引され、中長期的には緩やかな成長を予想しております。

当第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、データセンター関連投資の拡大を背景に、メモリーIC向けの製品の拡販が進むことにより、売上、利益ともに前年同期を上回ることを予想しております。通期の業績予想につきましても、新型コロナウイルス感染症や米中貿易摩擦による影響が不透明であることや、当第3四半期以降、売上構成の変化による利益面への影響が予想されるものの、メモリーIC向けを中心に引き続き底堅い需要が見込まれることにより、売上、利益ともに前年度を上回ることを予想しております。

注) 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. 配当予想について

(1) 2021年3月期配当予想の内容

	年間配当金 (円)		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想	—	—	—
今回予想	7円	7円	14円
(ご参考) 前期実績 (2020年3月期)	5円 (普通配当) 5円	8円 (普通配当) 5円 (記念配当) 3円	13円 (普通配当) 10円 (記念配当) 3円

(2) 配当予想の概要

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の継続を基本とし、業績に応じて積極的な株主還元を行うことを基本方針としています。

当期の配当予想につきましては、連結業績の見通しの算定が困難であったことから未定としておりましたが、前記の連結業績予想及び今後の事業展開等を踏まえ、上記の内容といたします。

以上